



辛耘 (3583)

2023年9月5日

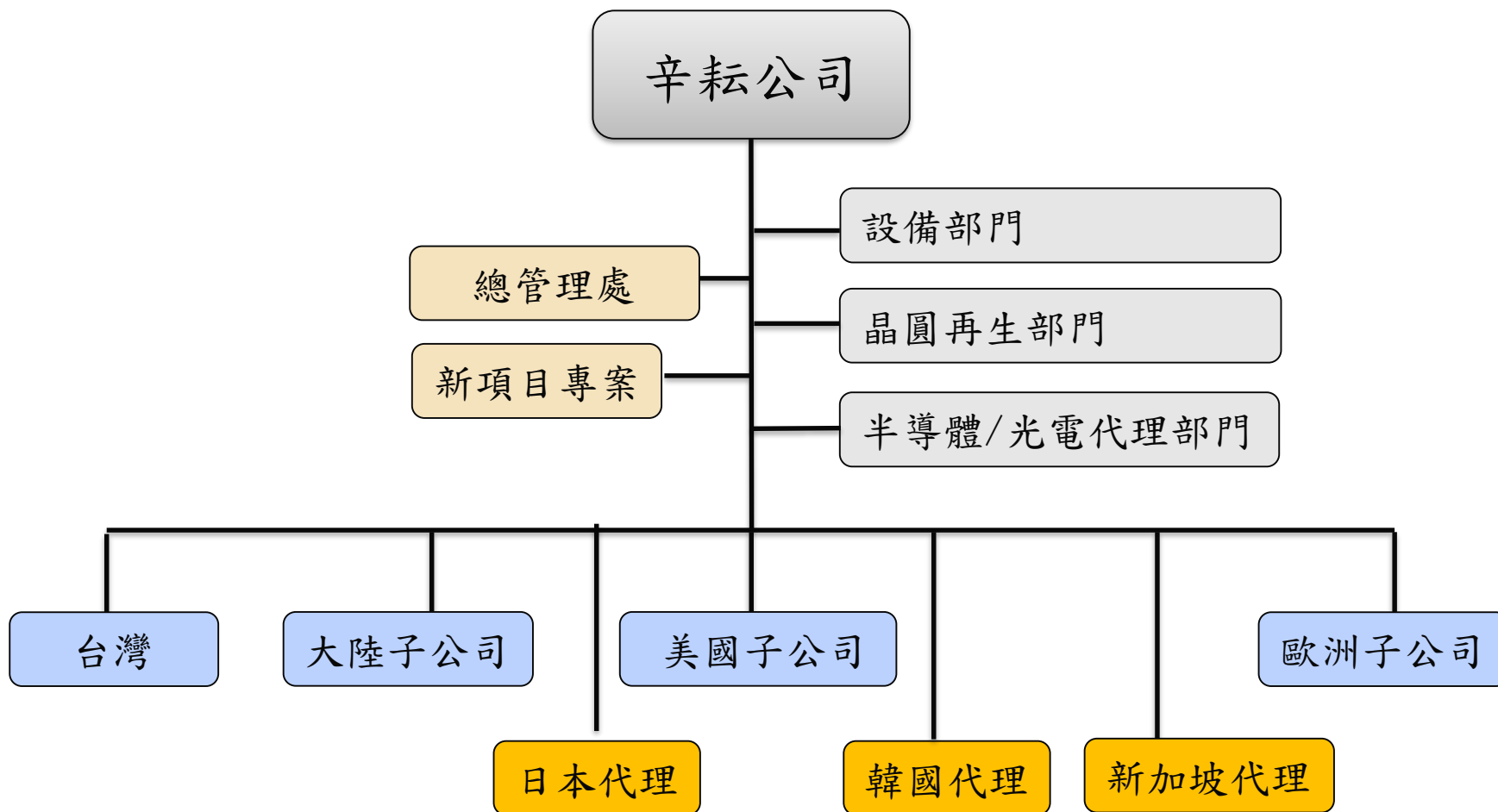
免責聲明

- 本簡報可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時又受限於已知或未知的風險與不確定性的影響。因此實際結果將可能不同於表述內容。
- 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

基本資料

成立時間	1979/10/17
董事長	謝宏亮
執行長	許明棋
資本額	8.11億元
營收(2021)	46.84億元(集團合併)
員工人數	770人(集團合併)
據點	台北、湖口、新竹、台南、高雄、大陸(上海等17個城市)、香港、美國、歐洲(奧地利)、日本、新加坡、韓國
主要業務	自製設備、晶圓再生、設備代理

辛耘公司組織架構



營運概況

主要產品

公司治理

未來展望

營運概況

簡明損益表



單位：百萬	2018	2019	2020	2021	2022	2023/H1
營業收入	<u>3,988</u>	<u>3,949</u>	<u>3,580</u>	<u>4,684</u>	<u>5,650</u>	<u>3,230</u>
營業毛利	<u>1,448</u>	<u>1,384</u>	<u>1,456</u>	<u>1,667</u>	<u>2,084</u>	<u>969</u>
營業費用	935	997	991	1,112	1,374	685
營業淨利	514	387	465	555	710	284
營業外收入及支出	26	16	(76)	(31)	26	86
稅前淨利	540	403	389	524	736	370
本期淨利	418	323	305	420	568	299
EPS(元)	<u>5.16</u>	<u>4.02</u>	<u>3.80</u>	<u>5.23</u>	<u>7.08</u>	<u>3.73</u>
毛利率	36%	35%	41%	36%	37%	30%
營業淨利率	13%	10%	13%	12%	13%	9%
稅前淨利率	14%	10%	11%	11%	13%	11%

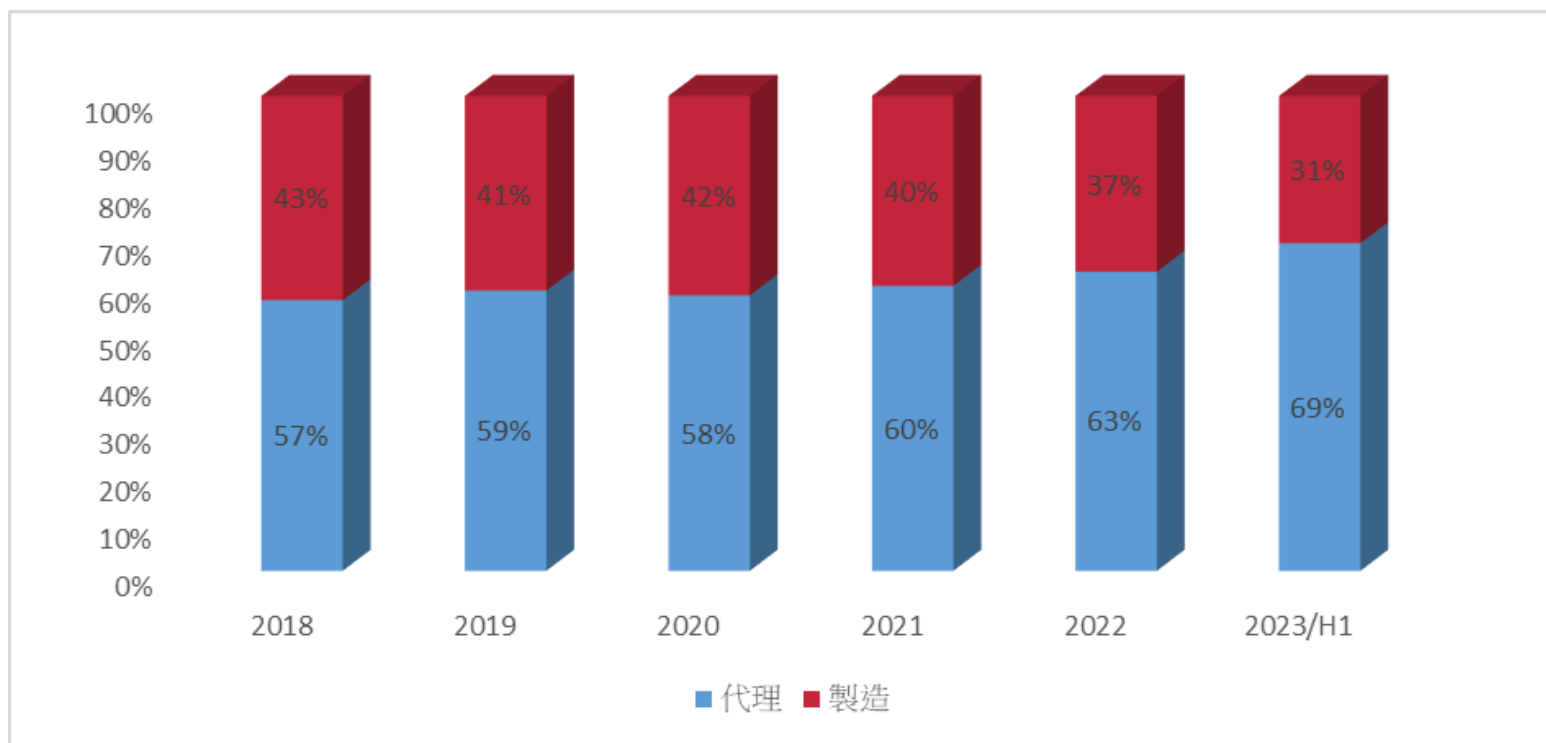
營運概況

2023/Q1 營運概況

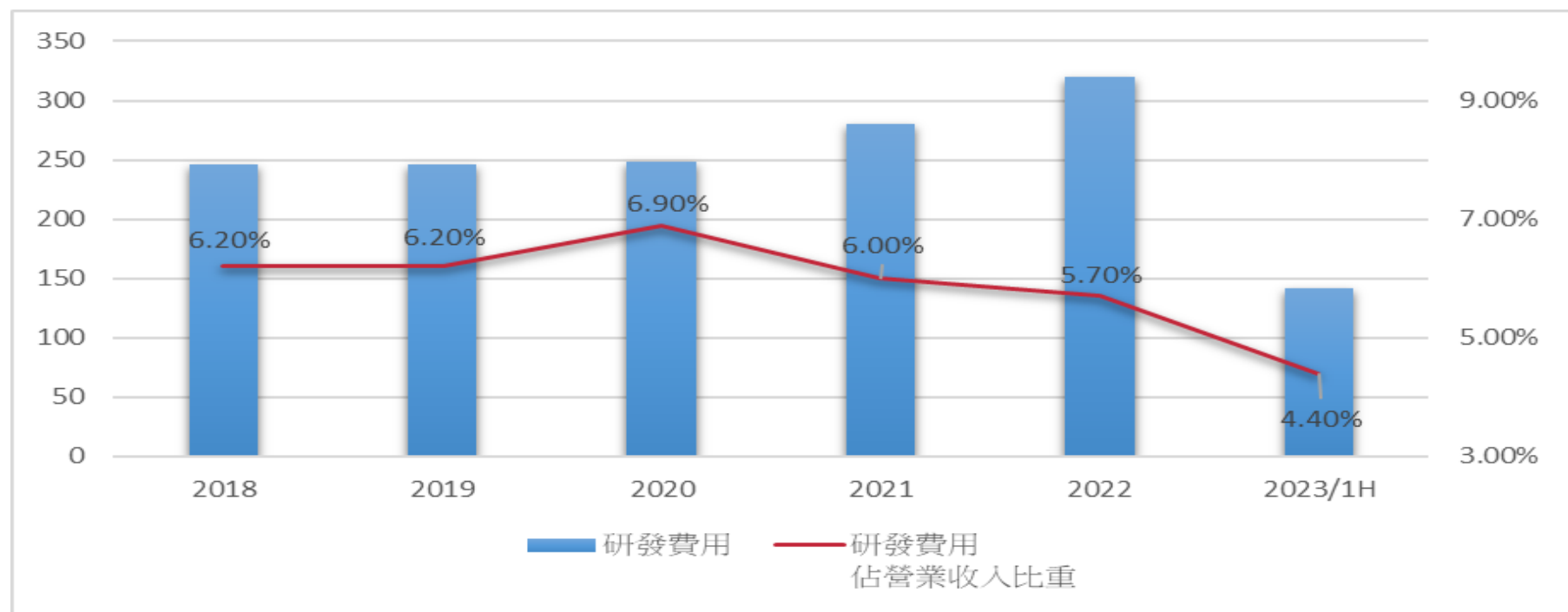


單位：百萬	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	YoY
營業收入	1,254	1,383	1,440	1,573	1,618	1,611	16%
營業毛利	461	511	536	576	515	457	-10%
營業費用	332	338	354	350	329	356	5%
營業淨利	129	173	183	225	186	98	-43%
營業外收入及支出	26	3	28	(30)	(8)	94	3275%
稅前淨利	155	176	211	195	178	192	9%
本期淨利	121	152	152	143	145	154	%
EPS(元)	1.51	1.89	1.89	1.79	1.81	1.92	1%
毛利率	36.8%	36.9%	37.2%	36.6%	32.1%	28.3%	-8.6ppt
營業淨利率	10.3%	12.5%	12.7%	14.3%	11.5%	6.1%	-6.4ppt
稅前淨利率	12.4%	12.7%	14.6%	12.4%	10.9%	11.9%	-0.8ppt

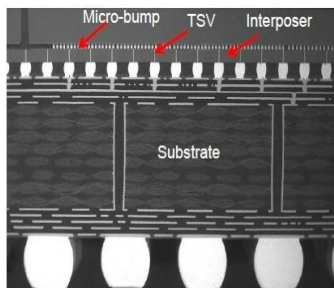
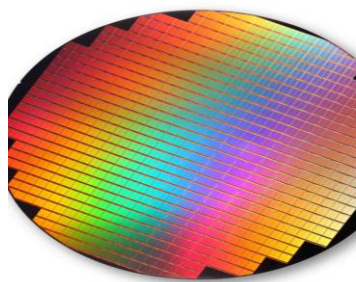
單位：%	2018	2019	2020	2021	2022	2023/H1	毛利率
代理	57	59	58	60	63	69	低於平均
製造	43	41	42	40	37	31	高於平均



單位：百萬	2018	2019	2020	2021	2022	2023/1H
研發費用	246	246	248	280	320	142
研發費用 佔營業收入比重	6.2%	6.2%	6.9%	6.0%	5.7%	4.4%



- 我們服務的產業：
 - 半導體 (前段/先進封裝)
 - 化合物半導體
 - LED / Mini LED / Micro LED
 - 平面顯示器 (TFT-LCD, AMOLED, Touch Panel)
 - 太陽能/電池
 - 生物科技/分析儀器



- 半導體
- 化合物半導體
- LED
- 平面顯示器
- 太陽能/電池
- 生物科技/分析儀器

設備生產

- 濕式製程設備
- 暫時性貼合及剝離設備
- 半導體/化合物/LED

代理事業

晶圓再生

- 12" Si (矽) Wafer
- 6" SiC (碳化矽)

● 辛耘公司



SCIENTECH

■ 12"Si晶圓再生

- ◆ 產能: 12 → 14 → 16萬/月
- ◆ 銅及非銅製程分離

■ SiC長晶後全製程及晶圓再生

- ◆ 產能: 800 / 月

Advanced clean technology

- 65nm/ 45nm Particle
- Low trace metal (<1E10)



Complete particle inspection
(SP1-DLS & SP2)

Cleaning

Etching

Full Process
Optimization



Polishing

Grinding

Complete polishing process

Super flatness
(GBIR<0.5μm)

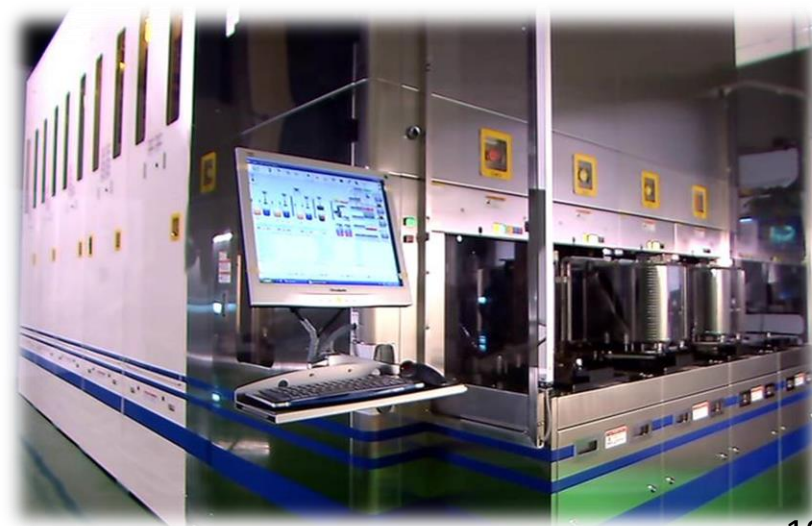


- 辛耘公司



SCIENTECH

- 批次式及單晶圓濕式製程設備
- 應用：
 - ◆ 半導體先進封裝製程
 - ◆ 半導體前段製程
 - ◆ 化合物半導體製程
 - ◆ 微機電製程
 - ◆ LED/Mini-LED/Micro-LED製程



- 辛耘公司



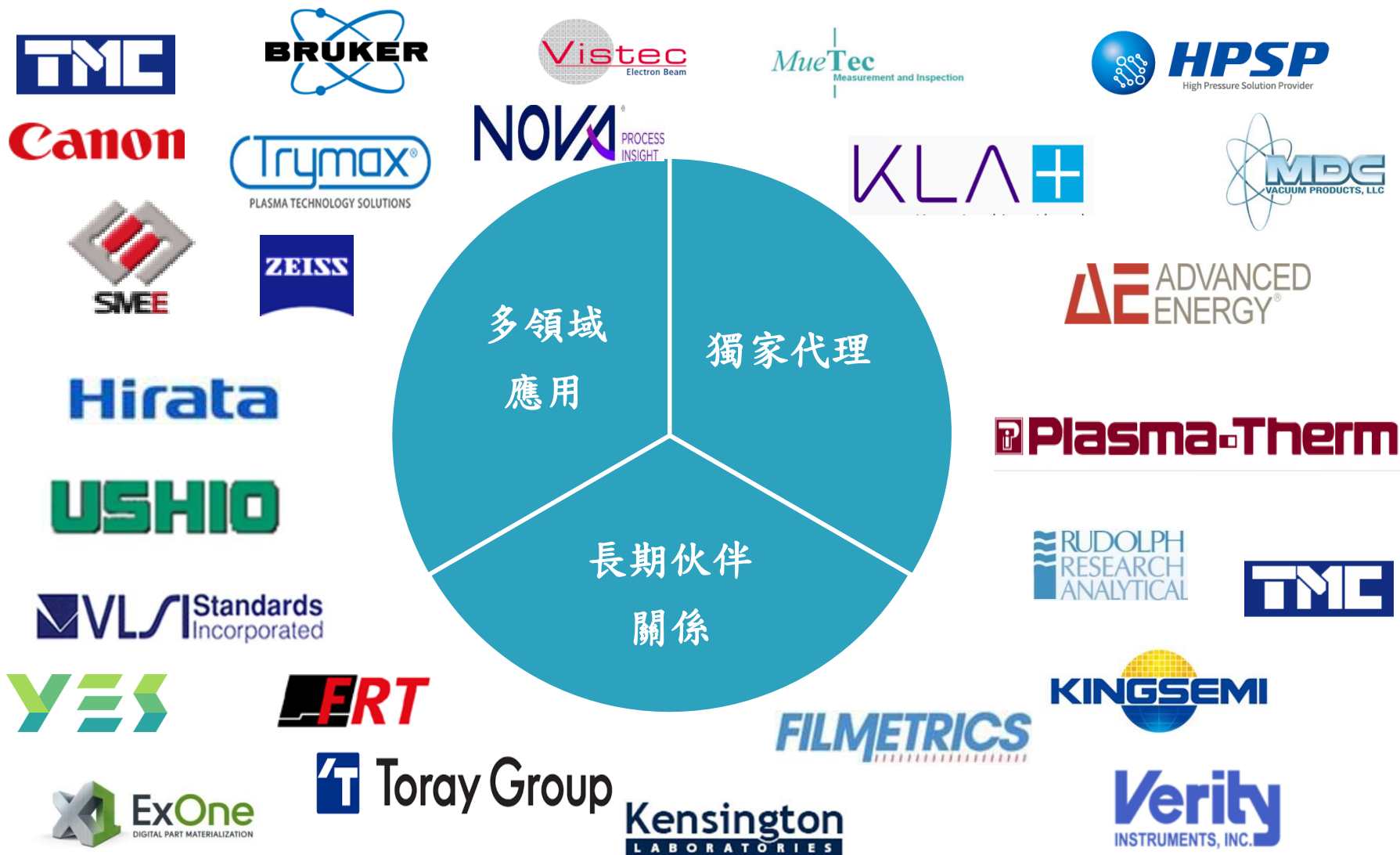
SCIENTECH

- 暫時性貼合及剝離設備(TBDB)
- 應用: IGBT功率器件, 半導體先進封裝
 - ◆ 暫時性貼合設備
 - ◆ 暫時性剝離設備
 - ◆ 解離層塗佈設備
 - ◆ 承載盤清洗設備



主要產品

設備代理



公司治理

ISO



Initial Certification

2014/5/27

Valid Date :

2020/5/28 ~ 2023/5/27



Issue 4. Certified since

2010/3/24

Valid Date :

2019/4/30 ~ 2022/4/30



Issue 3. Certified since

2019/4/30

Valid Date :

2019/4/30 ~ 2022/4/30



Issue 1. Certified since

2019/11/20

Valid Date :

2019/11/20 ~ 2022/11/19



Issue 1. Certified since

2021/09/29

Valid Date :

2021/09/29 ~ 2024/09/28



ISO9001

ISO14001

ISO45001

ISO27001
資訊安全

ISO22301
營運持續



Taiwan Intellectual Property Management System

台灣智慧財產管理規範 (TIPS) 驗證登錄證書

Certificate of Taiwan Intellectual Property Management System

貴公司所建置之智慧財產管理制度，通過台灣智慧財產管理規範 (TIPS) 推行體系之驗證，特此證明。相關登錄事項如下：

- 一、公司名稱：辛耘企業股份有限公司
- 二、受評部門：全公司
- 三、受評地址：新竹縣礁口鄉中華路 18 號
- 四、證書編號：TIPS-2016-驗證-008
- 五、有效期限：2021/12/31
- 六、管理標的：☒專利 ☒商標 ☒著作權 ☒營業秘密 ☐積體電路佈局
- 排除適用：無
- 七、驗證類別：☒AA 級 ☐A 級 (2016 年版)

經濟部工業局 呂正華

Certificate of Compliance

This is to certify that the Intellectual Property Management System of the following organization has been verified and fulfilled the requirements of TIPS.

- 1. Company Name : Sciencetech Corporation
- 2. Registered Department : All Company
- 3. Registered Address : No. 18, Zhonghua Rd., Hukou Township, Hsinchu County 30352, Taiwan (R.O.C.)
- 4. Number of Registration : TIPS-2016-cert-008
- 5. Date of Expiration : December 31, 2021
- 6. Items : ☒ Patent ☒ Trademark ☒ Copyright ☒ Trade Secret ☐ Integrated Circuit Layout
- Exclusion : None
- 7. Certification Level : ☒ AA ☐ A (2016)

Director General
Industrial Development Bureau, MOEA Richard Lee

簡報結束
謝謝！

Q&A